Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

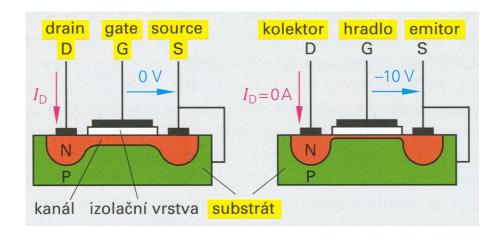
Ústav elektrotechniky a měření

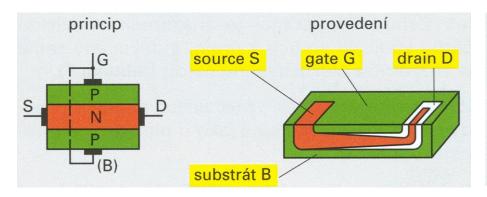
Unipolární tranzistory

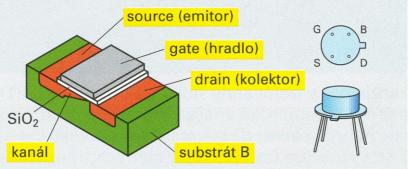
Přednáška č. 5

Milan Adámek

<u>adamek@ft.utb.cz</u> *U5 A711* +420576035251







- výstupní (zatěžovací) proud teče jen jedním typem polovodiče (*vodivým kanálem*), neprochází tedy přes PN přechod jako u bipolárního
- proud ve vodivém kanálu je řízen elektrickým polem jde o FET tranzistory (Field Effect Transistor)
- vodivý kanál může být typu P nebo N jde o FET s kanálem
 N nebo P
- koncové elektrody mají názvy: Source (zdrojová elektroda)
 Drain (odvod nábojů)
 Gate (řídicí elektroda)

- při výrobě FET je planární technologií v monokrystalu typu N nebo P vytvořen vodivý kanál difuzí tak, aby měl vodivost opačného typu než monokrystal **substrát B** (angl. Bulk hlavní část)
- substrát musí být vodivě spojen se Source, aby se při řízení mohly vyměňovat nosiče náboje mezi substrátem a kanálem
- vysoká dotace P+ na kontaktních plochách s kovovými elektrodami zabraňuje vytvoření závěrné vrstvy mezi kovem a polovodičem

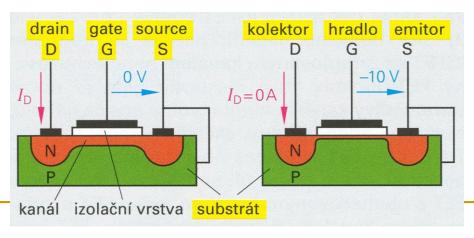
- Gate musí být izolován od kanálu, aby neprotékal proud mezi Source a Gate
- izolaci lze realizovat dvojím způsobem:
 - Izolační vrstvou jde o IGFET
 - PN přechodem jde o JF-ET

Princip činnosti

- název IGFET (Insulated Gate FET)
- izolační vrstva slouží pro oddělení Gate od kanálu
- na izolaci je napařen kov (elektroda Gate)

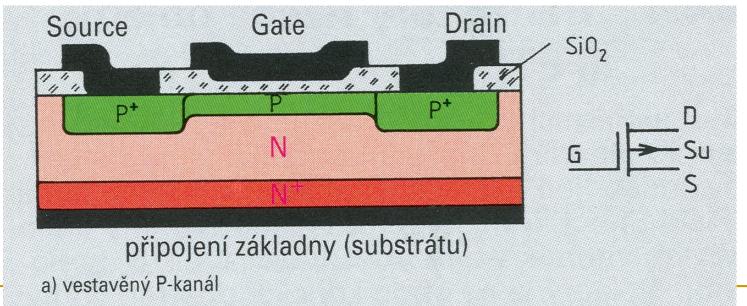
Podle izolační vrstvy a substrátu se IGFET dělí na:

- 1. MOSFET (Metal Oxid Semiconductor FET)
 - izolační vrstva je SiO₂, substrát tvoří křemík
- 2. MISFET (Metal Insulator Semiconductor FET)
 - izolační vrstva SiO₂, substrát galliumarsenid

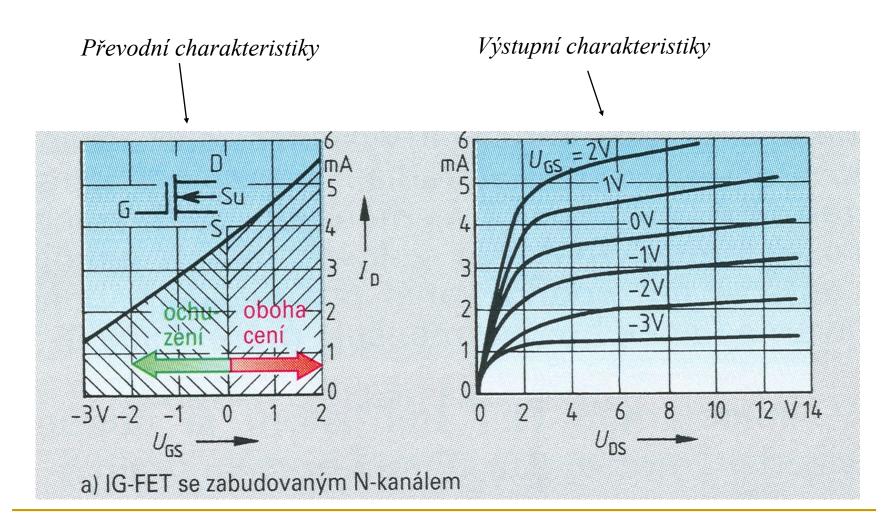


Druhy IGFET tranzistorů

- IGFET se zabudovaným (vestavěným) kanálem =ochuzovaný FET kanál je vodivý i při U_{GS} =0 elektrické pole U_{GS} vytlačuje nosiče nábojů a přiškrcuje tak kanál
- v IGFET s N kanálem pro U_{GS}>0 se začnou elektrony nasávat do kanálu
- v IGFET s N kanálem pro U_{GS}<0 se začnou elektrony odčerpávat z kanálu –dojde k ochuzení kanálu o volné nosiče nábojů

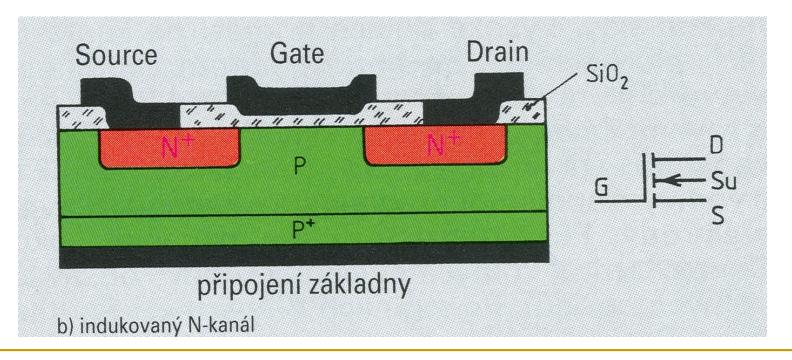


Charakteristiky IGFET tranzistorů se zabudovaným kanálem

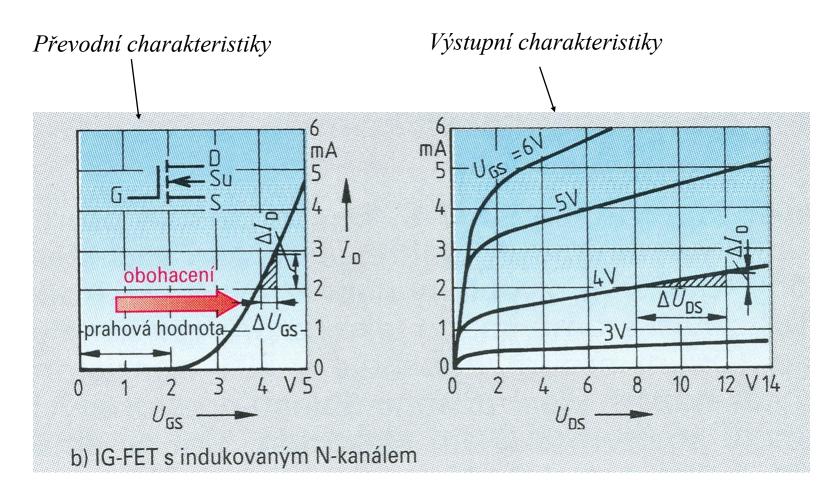


Druhy IGFET tranzistorů

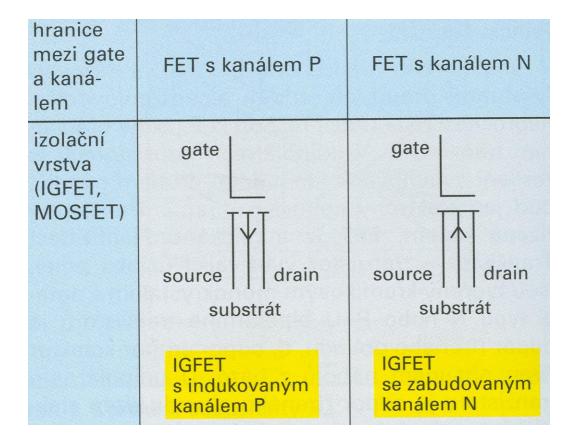
• IGFET s indukovaným kanálem = FET s obohaceným kanálem kanál je nevodivý při $U_{GS}=0$ – vodivý kanál je nutno vytvořit přiložením napětí mezi S a G



Charakteristiky IGFET tranzistorů s indukovaným kanálem

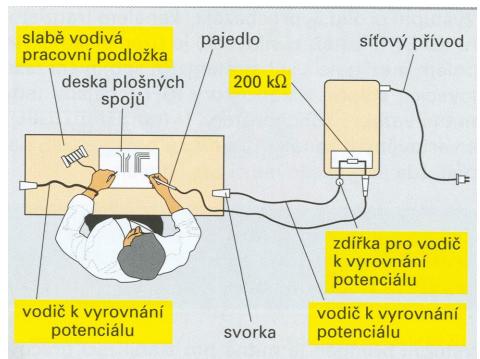


Schématické značky IGFET tranzistorů

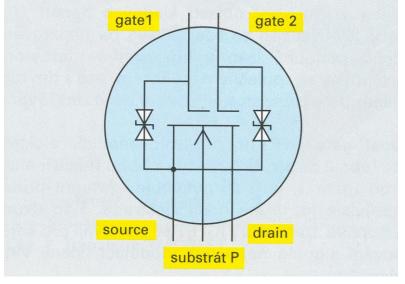


Pravidla při manipulaci s IGFET tranzistory

- protože elektroda Gate je galvanicky oddělena od kanálu, může se elektrostaticky nabíjet na vysoké napětí – dojde k proražení izolace
- při transportu a skladování je nutno spojit vývod Gate s ostatními vývody – tyto vodivé spoje lze odstranit až po zapájení tranzistoru
- při pájení těchto tranzistorů je třeba zajistit jejich ochranu pomocí speciálního pracoviště
- pro odstranění problémů se vyrábí IGFET s ochrannými přepěťovými diodami - transily



Pracovní místo pro práci s tranzistory MOSFET



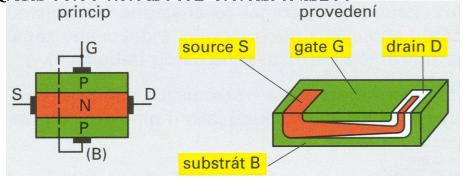
IGFET s dvojitou řídicí elektrodou a ochrannými přepěťovými diodami

JF-ET tranzistory

Princip činnosti

- název JF-ET (junction FET, z angl. spojení), často označované jako PNFET
- vodivý kanál může být P nebo N (častější je kanál N kvůli pohyblivosti elektronů)
- elektroda Gate je vytvořena z opačného polovodiče než je vodivý kanál (vznikne vždy přechod PN)

 mezi Gate a vodivým kanálem je izolace vytvořena závěrnou vrstvou PN přechodu (při správné polarizaci)
 provedení



JF-ET tranzistory

Princip činnosti

- účinný průřez kanálu je tím menší, čím vyšší je napětí Gate Source
- toto předpětí mezi Gate Source se nesmí přepólovat, jinak by se zrušila závěrná vrstva

